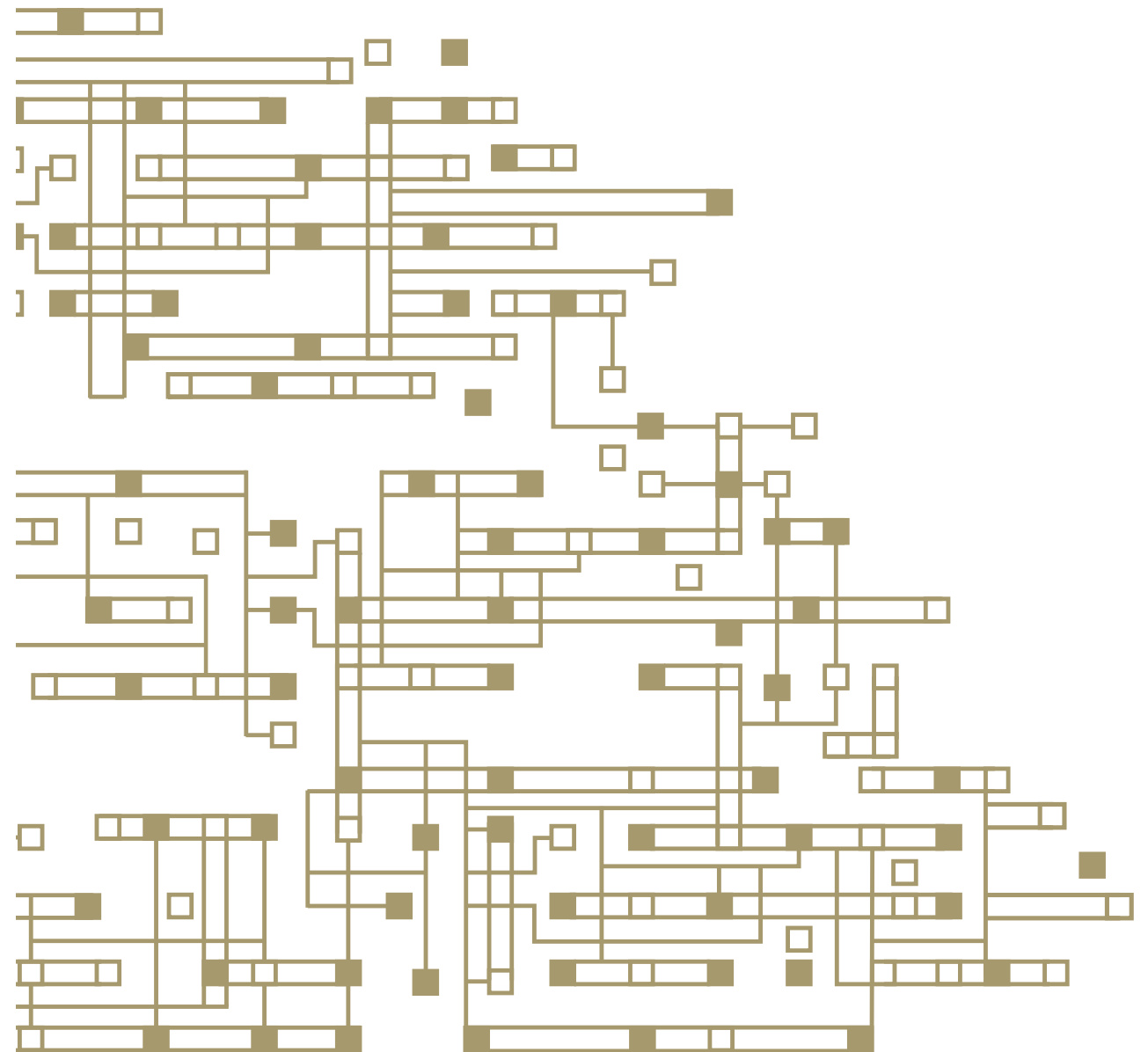


台灣積體電路製造股份有限公司

民國九十九年 營運報告



台灣積體電路製造股份有限公司
300-78新竹科學工業園區力行六路8號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000
<http://www.tsmc.com>



台積公司願景與核心價值

願景

成為全球最先進及最大的專業積體電路技術及製造服務業者，並且與我們無晶圓廠設計公司及整合元件製造商的客戶群共同組成半導體產業中堅強的競爭團隊。

為了實現此一願景，我們必須擁有三位一體的能力：

- (1) 是技術領導者，能與整合元件製造商中的佼佼者匹敵；
- (2) 是製造領導者；
- (3) 是最具聲譽、以服務為導向，以及客戶最大整體利益的提供者。

核心價值

誠信正直

這是我們最基本也是最重要的理念。我們說真話；我們不誇張、不作秀；對客戶我們不輕易承諾，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；對同業我們在合法範圍內全力競爭，我們也尊重同業的智慧財產權；對供應商我們以客觀、清廉、公正的態度進行挑選及合作。在公司內部，我們絕不容許貪污；不容許有派系；也不容許「公司政治」。我們用人的首要條件是品格與才能，絕不是「關係」。

承諾

台積公司堅守對客戶、供應商、員工、股東及社會的承諾。所有這些權益關係人對台積公司的成功都相當重要，台積公司會盡力照顧所有權益關係人的權益。同樣地，我們也希望所有權益關係人能對台積公司信守其承諾。

創新

創新是我們的成長的泉源。我們追求的是全面，涵蓋策略、行銷、管理、技術、製造等各方面的創新。創新不僅僅是有新的想法，還需要執行力，做出改變，否則只是空想，沒有益處。

客戶夥伴關係

客戶是我們的夥伴，因此我們優先考慮客戶的需求。我們視客戶的競爭力為台積公司的競爭力，而客戶的成功也是台積公司的成功。我們努力與客戶建立深遠的夥伴關係，並成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴。

目錄

 1. 致股東報告書	2
 2. 公司簡介與市場概況	6
 3. 公司治理	10
 4. 營運概況	12
 5. 企業社會責任	16
 6. 財務概況	20

【瞻】

我們以宏觀的視角綜覽過去與未來，
以堅強的實力克服挑戰。



1. 致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國九十九年是台積公司營收及獲利再創高峰的一年。在這一年，由於全球經濟日益復甦，整體半導體產業營收成長了31%，而若以美元為計算單位，台積公司全年營收上揚了48%，優於同期專業積體電路製造服務領域的43%。我們的成長動能來自及時而快速的產能擴充、客戶對我們先進製程的廣泛應用以及在特殊製程方面強勁的營收成長。

台積公司民國九十九年的優異成績，是我們「先進技術、卓越製造、堅強的客戶夥伴關係」三大競爭優勢充分展現的成果。重要的成就包括：

- 所有廠區全年產能利用率總平均達百分之百，同時總體建置產能較前一年增加14%，其中十二吋晶圓廠的產能增加37%。
- 民國九十九年，我們提供超過157種製程技術，為450多個客戶生產超過8,300種不同產品。
- 民國九十九年，我們快速量產40/45奈米製程技術，其營收已佔台積公司全年晶圓銷售的17%，並擁有可觀的市場佔有率，且在民國九十九年底，已達到公司的平均獲利水準。
- 承繼65奈米與40奈米製程技術的優異表現，28奈米製程技術的開發也如同預期順利進行，包括三種高介電層/金屬閘（High-k Metal Gate）製程及一種傳統的氮氧化矽製程，而先期合作的客戶數目也刷新紀錄。

財務表現

台積公司民國九十九年全年合併營收為新台幣4,195億4,000萬元，較前一年的2,957億4,000萬元增加41.9%；稅後淨利為新台幣1,616億1,000萬元，較前一年的892億2,000萬元增加81.1%；每股盈餘為新台幣6.23元，較前一年的3.44元上揚了81.1%。

以美元為計算單位，民國九十九年全年合併營收達133億2,000萬美元，稅後淨利為51億3,000萬美元，而前一年度全年合併營收為90億美元，稅後淨利則是27億1,000萬美元。

台積公司民國九十九年毛利率為49.4%，前一年為43.7%；營業利益率為37.9%，前一年為31.1%。稅後淨利率則為38.5%，較前一年增加8.3個百分點。台積公司民國九十九年全年晶圓出貨量為1,186萬片八吋約當晶圓，較民國九十八年的774萬片八吋約當晶圓成長。

擴大成長

民國九十九年，台積公司積極開發先進製程技術並加速產能擴充的步伐。為進一步強化我們的技術領導地位，台積公司持續投入相當可觀的研發資源，民國九十九年的研發資本支出是3億5,500萬美元，比前一年度提高85%；經常性研發預算則增加40%至9億4,000萬美元。其中，研發投資的焦點主要擺在28奈米、20奈米、14奈米製程的更進一步發展及鑽研更先進的10奈米、7奈米製程技術。

民國九十九年，為滿足廣大客戶的產能需求，台積公司全年資本支出創下紀錄，達到59億4,000萬美元。儘管已經竭盡全力加速產能擴張，但至民國九十九年底，仍有甚多客戶的產能需求尚待滿足。

除了繼續投資擴充二座既有的十二吋超大晶圓廠（GIGAFAB™）一位於新竹的晶圓十二廠及位於台南的晶圓十四廠的產能外，民國九十九年七月，我們也在位於台中的中部科學園區動土興建第三座十二吋超大晶圓廠—晶圓十五廠；同時，也在新竹科學園區取得新的廠房用地，以延續14奈米及更先進製程技術的研究發展。

此外，台積公司也積極以固有的技術優勢、工程能力、大規模製造的豐富經驗來創造營收成長的新機會。民國九十九年，我們在新竹開始建造首座LED照明事業廠房，以尋求在照明產業的發展機會。同時，第一座先進薄膜太陽能技術研發中心暨廠房也在台中興建中，為台積公司進軍薄膜太陽能市場奠定厚實基礎。上述每一項新事業的投入，都代表一個新契機，是台積公司跨入綠色能源新事業的重要立足點。

技術發展

台積公司在28奈米製程技術的開發上領先專業積體電路製造服務同業，並已具備量產能力。我們的研發成果顯示，採用28奈米後閘極（Gate-last）高介電層／金屬閘製程所產出的晶片，其可靠度、密度可較前一代40奈米製程晶片高出一倍。目前，許多客戶的產品已經完成光罩製作，並開始進行原型試製。此外，我們的28奈米無鉛凸塊封裝技術不僅對環境友善，並適用超低電阻的超低介電層（ELK）導線。

除了積極進行先進製程技術研發以繼續推進摩爾定律，我們也不斷投入資源發展特殊製程技術，滿足將互補金屬氧化物半導體（CMOS）邏輯製程與更多特殊製程整合的產業趨勢，並掌握持續微縮製程以獲致成本與產品尺寸的優勢，充分因應市場需求。

台積公司的特殊製程技術擁有領導優勢，不僅能提升晶片的效能，更擁有優異的製程微縮能力，並已獲得多項業界領先成果：我們計劃採用65奈米及90奈米製程技術來生產車用引擎控制晶片，並以65奈米背面感光（BSI）影像製程技術，協助互補金屬氧化物半導體影像感應處理器達到最佳的光電量子效率（Quantum Efficiency）。在嵌入式動態隨機存取記憶體方面，我們採用40奈米製程成功開發出最快速的網路處理器；在嵌入式快閃記憶體方面，我們採用0.11微米技術，成功產出每微米1微微安培（1pA/μm）超低漏電流的微控制器（MCU）；在微機電系統（MEMS）方面，我們以0.18微米製程，完成互補金氧半導體—微機電（CMOS-MEMS）的三維整合；而在電源晶片方面，我們採用0.18微米製程，產出業界導通電阻（Ron）值最小的晶片。

我們在延伸摩爾定律與發展特殊製程的種種努力，已經更進一步擴展台積公司與眾多客戶更深更廣的合作關係。

榮譽與獎項

台積公司在民國九十九年，持續得到來自全球各地的獎項與肯定，表揚我們各方面的傑出表現。我們致力提升股東權益的承諾，以及對企業社會責任的重視，已經獲得了AsiaMoney、FinanceAsia、IR Magazine、Corporate Governance Asia、天下雜誌以及遠見雜誌等單位頒發在公司治理、經營管理、投資人關係、企業社會責任上的多項大獎，並榮獲台灣永續能源研究基金會「2010台灣企業永續報告獎」的最高榮譽—大型製造業組金獎。同時，我們在民國九十九年更名列道瓊永續指數全球半導體類別企業中的領先者（Leader），並連續十年獲選為道瓊企業永續經營指數的組成企業。

此外，國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）已經宣佈我為該學會最高獎章「2011 IEEE Medal of Honor」得主，以表彰我在半導體產業卓越的領導地位，這是屬於全公司同仁的榮耀。

未來展望

展望民國一百年，全球經濟預估將會持續復甦，全球半導體產業營收預計將增加約5%，而專業積體電路製造服務領域的成長將會優於整體半導體產業，成長率預計約15%。台積公司擁有最佳的技術、有效的產能及客戶所賦予的信賴，這樣的實力已為我們在專業積體電路製造服務領域贏得最有利的地位，得以更進一步提升我們的市場佔有率，並為股東們繼續帶來獲利與成長。



張忠謀

張忠謀
董事長兼總執行長

【誠】

誠信正直是我們最基本，也是最重要的理念。

2. 公司簡介及市場概況

公司簡介

台積公司成立於民國七十六年二月二十一日，總部設立於台灣新竹科學工業園區，是全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司開創並專注於生產客戶設計之晶片，身為專業積體電路製造服務公司，台積公司並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保不與客戶競爭。

台積公司的客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。

民國九十九年，台積公司所擁有及管理的產能達到1,133萬片八吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有二座先進的十二吋晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家海外子公司WaferTech美國子公司、台積電（中國）有限公司及其他轉投資公司之八吋晶圓廠產能支援。

台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。至民國九十九年底，台積公司全球員工總數超過3萬3,000人。

台積公司在先進製程技術及超越摩爾定律（More-than-Moore）的發展上持續領先專業積體電路製造服務領域，不僅率先將65奈米和40奈米先進製程技術導入量產，亦宣佈提供28奈米全世代製程技術，包括支援高效能表現的28奈米高效能高介電層／金屬閘（簡稱28HP）以及28奈米高效能行動運算製程技術（簡稱28HPM）製程外，亦提供支援低耗電表現的28奈米低耗電氮氧化矽（簡稱28LP）製程技術及28奈米低耗電高介電層／金屬閘（簡稱28HPL）技術，提供客戶更完備的28奈米製程技術選擇。除了一般邏輯製程技術，台積公司也針對客戶需求提供廣泛的製程技術，例如：非揮發性嵌入式記憶體（Embedded Non-volatile Memory）製程、嵌入式動態隨機存取記憶體（Embedded DRAM）製程、混合訊號／射頻（Mixed Signal/RF）製程、高壓（High Voltage）製程、互補金屬氧化物半導體影像感測器（CMOS Image Sensor）、彩色濾光片（Color Filter）、微機電系統（MEMS）、矽鍺（Silicon Germanium）製程，及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務（Automotive Service Packages）等。

民國九十九年，台積公司投資固態照明及太陽能相關的二項新事業，目前該二項新事業仍在技術開發階段，預計至民國一百年前不會對公司營收有顯著貢獻。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為TSM。

台積公司卓越表現

民國九十九年，即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之專業積體電路製造服務領域，仍以45.5%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。民國九十九年，約有72%的營收來自0.13微米及其他更先進的製程；同年十一月，更成功締造了45/40奈米十二吋晶圓出貨第五十萬片的新里程碑。另外，台積公司也領先專業積體電路製造服務領域，推出28奈米製程。民國九十九年第四季，台積公司52%的晶圓製造服務營收來自65奈米及其他更先進製程。

台積公司以成為客戶最佳合作夥伴為目標，除了提供先進的製程技術，同時也提供創新的服務。台積公司在民國九十九年發表領先專業積體電路製造服務領域的類比／混合訊號參考設計流程，並推動Soft IP矽智財聯盟（Soft IP Alliance），讓Soft IP業者將耗電、效能與面積等方面的考量在台積公司的技術基礎上予以最佳化。同時，透過第二版射頻參考設計套件的發佈，進一步強化開放創新平台（Open Innovation Platform™），為半導體設計業帶來最具時效的創新。台積公司在民國九十八年首次發表可交互操作的多項電子設計自動化技術檔案格式（iRCX、iDRC、iLVS、iPDK），並在民國九十九年提供業界第一套從0.13微米到28奈米的iDRC/iLVS/iPDK技術檔案，實現台積公司不斷為客戶提供更好設計生態環境的承諾。

台積公司持續提升半導體製程技術，在民國九十九年開發和已提供的製程包括：

- 支援如中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、加速處理器（APU）、場域可程式化閘陣列（FPGA）及高速網路控制器等性能導向之應用的28奈米高效能運算製程技術（28HP）。
- 支援平板電腦、智慧型手機及高端系統單晶片應用的28奈米高效能行動運算製程技術（28HPM）
- 符合主流智慧型手機、平板電腦及數位消費性電子產品需求的28奈米低功耗製程技術（28LP & 28HPL）
- 支援性能導向之應用市場如中央處理器（CPU）、場域可程式化閘陣列（FPGA）、三度空間影像（3D Image）、遊戲機及乙太網路控制器（Gigabit Ethernet）等應用的40奈米泛用型製程技術（40GP）
- 提供手機晶片、應用處理器、家庭娛樂系統、遊戲晶片及無線網路產品解決方案的4 0 奈米低功耗電及射頻製程技術（40LP & RF）
- 支援無線區域網路（WLAN）、手機基頻晶片（Cellular BB）、數位電視（DTV）、機頂盒（STB）、藍芽（Bluetooth）、可攜式媒體播放器（PMP）、行動上網裝置（MID）及手持裝置等高端應用的55奈米低功耗電射頻技術
- 與客戶共同開發符合高端車用電子應用的65奈米多次可程式非揮發性嵌入式快閃記憶體製程技術
- 支援智慧型手機面板驅動晶片的80奈米高壓製程
- 支援快閃記憶體控制器應用的85奈米低功耗製程
- 符合微控制器晶片應用規格的90奈米嵌入式快閃記憶體技術
- 支援車用電子應用的一次性可程式0.18微米及0.25微米製程技術並已通過驗證
- 0.18微米及0.25微米高精度類比製程技術
- 支援數位電源管理晶片的0.18微米雙極－互補金屬氧化半導體－雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）製程技術

此外，台積公司持續開發特殊製程技術，包括背面照度（Back-side Illumination）互補金屬氧化物影像感測器製程（BSI CIS）、90/65奈米嵌入式快閃記憶體製程及0.13微米類比製程。民國九十九年，台積公司更開始提供三維微機電系統（MEMS）平台給無晶圓廠客戶。這些特殊製程技術是台積公司與其他競爭者的重要差異，並能提供客戶更多價值。

市場概況

民國九十九年，全球半導體市場的產值估計約為美金2,980億元，與民國九十八年相較，成長32%。民國九十九年整體積體電路製造服務業產值約為美金280億元，年成長率43%，佔半導體產業產值的10%。民國九十九年，專業積體電路製造服務領域的最大市場（依據客戶總部所在地區）為北美地區，佔全球市場的59%；第二大市場為日本以外的亞太地區，佔27%；其次為歐洲市場佔9%；日本市場則佔5%。

專業積體電路製造服務市場的需求與供給

相較充滿挑戰的民國九十八年，積體電路製造服務領域的銷售在民國九十九年展現了43%的大幅成長，主要推力來自於終端市場需求復甦與供應鏈的存貨回補。

民國一百年專業積體電路製造服務領域預計將成長15%。展望未來，隨著全球經濟穩定發展、電子產品採用半導體元件的比率提升，及整合元件製造商擴大委外代工，從民國九十九年至民國一百零四年，專業積體電路製造服務領域的年複合成長率可望達到10%，較整體半導體產業4%年複合成長率為高。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品息息相關。

市場定位

身為專業積體電路製造服務領域的領導者，台積公司在民國九十九年的合併營收約為美金133億元，佔專業積體電路製造服務領域的45.5%。依據地區劃分，其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的67%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔15%、歐洲市場佔11%、中國大陸市場佔3%、日本市場亦佔4%。依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的27%、通訊相關產品佔43%、消費性電子產品佔13%、工業用等其他產品則佔17%。

新事業

台積公司於民國九十八年五月六日成立新事業組織，用以開拓專業積體電路製造服務外的市場機會。新事業組織在民國九十九年至一百年初之間，由兩個事業部所組成：專注於開發適用於各式照明應用的高效能發光二極體（LED）技術的固態照明事業，以及專注於生產銷售太陽光發電模組的太陽能事業。

固態照明事業於民國九十九年三月在新竹科學園區動土興建第一期生產廠房，於九月完工裝機，並於年底完成裝設試產線供技術研發活動使用，未來該試產線可進行擴充以因應正式量產之所需。

民國九十九年六月，台積公司透過其投資基金投資了5,000萬美元，取得生產薄膜太陽能電池模組的美商Stion公司21%的股權，同時並就CIGSS技術授權、生產供應以及合作開發方面簽訂一系列的協議。民國九十九年下半年，台積公司派遣工程與研發團隊前往Stion公司進行先期作業，以準備於民國一百年順利完成技術移轉工作；同年九月則在中部科學園區動土興建第一期生產廠房，預計在民國一百年第二季完工裝機。此外，台積公司亦於民國九十九年二月投資取得台灣太陽能電池生產商茂迪公司20%之股權。

3. 公司治理

董事會

台積公司的董事會由七位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，其中三位獨立董事分別為：前英國電信公司執行長彼得·邦菲爵士、前宏碁集團董事長施振榮先生，以及前德州儀器公司董事長湯馬斯·延吉布斯先生。在張忠謀董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依張董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，台積公司董事會已建立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核、內部檢舉系統等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整。

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

審計委員會及薪酬委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

至民國一百年二月底止，台積公司審計委員會由全體三位獨立董事組成並聘任一位財務專家。審計委員會組織章程請參考本公司網站。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

至民國一百年二月底止，本公司薪酬委員會共有四名成員，全體三位獨立董事為具有表決權的成員，董事長張忠謀博士為不具表決權之成員。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

【正】

我們堅持營運透明，
並以清廉、公正的態度客觀行事。



【創】

不斷追求包括策略、行銷、管理、
技術、製造等各方面的創新，
是我們成長的泉源。

4. 營運概況

技術領導地位

研發團隊之組織與投資

民國九十九年，台積公司持續增加研發投資，進一步強化三大核心競爭優勢中的技術領先優勢，全年研發預算約佔總營收之7%，此一研發投資規模不僅與眾多世界級一流半導體科技公司相當，甚至超越了許多公司的規模。由於研發預算增加，台積公司也同時擴增研發團隊人力，增幅超過17%。

有鑑於驅動互補金屬氧化物半導體（CMOS）製程微縮的摩爾定律是否能繼續延伸，已面臨眾多技術面之困難，台積公司持續努力提升其研發組織的能力，加上在擁有豐富半導體研發經驗的研發資深副總經理蔣尚義博士的領導之下，相信將能克服眾多技術上的挑戰。

民國九十九年，台積公司率專業積體電路製造服務領域之先，提供第一個28奈米製程技術。透過迅速密集的努力，此一先進製程技術已達到穩定的良率，提供客戶更佳的競爭優勢。同時，台積公司也加速了先進元件、嵌入式記憶體與超低介電層銅導線技術的發展。此外，台積公司於民國九十九年也領先專業積體電路製造服務領域，提供28奈米高介電層／金屬閘（HKMG）製程服務，並成功開拓了20奈米先進製程技術創新領域，再次證明了台積公司研發團隊堅實的能力。

台積公司亦致力於擴展與研發夥伴的合作以及與世界級研發機構的聯盟，例如：台積公司是位於歐洲的知名半導體技術研發中心IMEC的核心會員，同時也與矽智財公司策略合作，促成先進製程之矽智財研究發展。此外，台積公司也加強與主要合作夥伴對設計和製程做最佳化的研究開發，並持續贊助國內外主要的大學從事奈米科技研究，以推動創新及先進技術。

上述研發上的努力與投入，讓台積公司屢屢能夠領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶量產製程技術和設計解決方案，以協助客戶在複雜且充滿挑戰的市場環境成功推出其產品。

未來研發計劃

延續民國九十九年在先進技術研發上締造的優異成果，台積公司未來將繼續擴展其研發投資，並進一步擴充十二吋晶圓研發試產線，以加速28奈米製程的量產擴增，和20奈米製程的研發工作。此外，也將進一步強化前瞻性技術研究，繼續研發新的電晶體及製程技術，例如3D結構、應變層（Strained-layer）互補金屬氧化物半導體、高載子移動率材料以及創新的3D直通矽晶穿孔封裝與中介轉接層晶片技術平台等。目前，奈米級電晶體的基本物理和其特性的研究是台積公司研發的重點工作之一，以作為了解及引導未來先進製程元件的設計方向。台積公司已經運用相關的研發成果，確保台積公司在28奈米和20奈米製程技術世代的領先地位。台積公司的目標之一，是藉由內部的創新來延伸摩爾定律，同時也與產業領導者及學術界共同合作，尋求具有成本效益的製程技術及製造解決方案。

台積公司將繼續與國際聯盟組織及光學微影設備供應商合作，確保能夠即時進行193奈米波長高數值孔隙（NA）掃描機技術、極紫外線（EUV）微影技術以及多重電子束投影技術的開發，以支援20奈米、14奈米及更先進技術的製程研發工作。

卓越製造

超大晶圓廠（GIGAFAB™）

台積公司的十二吋超大晶圓廠是台積公司製造策略的關鍵。台積公司目前擁有二座十二吋超大晶圓廠一晶圓十二廠及晶圓十四廠。民國九十九年，這二座超大晶圓廠的總產能已達到252萬片十二吋晶圓，目前提供0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、28奈米全世代以及其半世代設計的生產，並保留部分產能作為研發用途，以支援20奈米、14奈米及更先進製程的技術發展。台積公司座落於中部科學園區的第三座十二吋超大晶圓廠一晶圓十五廠，也預計於民國一百年第二季開始進行裝機。

台積公司的整合製造管理平台能讓客戶除了可以得到相同的品質與可靠度的表現，還能享有更大的產能彈性、縮短良率學習曲線、量產時間，並減少昂貴的產品重新認證所需要的流程。

機台效能最佳化

台積公司利用先進機台控制（Advanced Equipment Control）與即時缺陷偵測（Fault Detection）等最先進的資訊科技系統，來優化機台效能，並改善機台效率。

精準製造

台積公司獨有的製造架構，是為擁有複雜產品組合的專業積體電路製造服務所量身訂作的。為了卓越製造的承諾，台積公司發展出最精細複雜的排程、即時派工與物料自動搬運系統，不斷改善並簡化生產流程，以期能在最短時間內用最有效的方式服務客戶。台積公司透過即時監控、分析與診斷機台生產力，能將生產的干擾降到最低，並獲得最佳的成本效益。

邁向十八吋晶圓製造

台積公司致力於半導體業十八吋晶圓的轉換，此舉將有助提供業界持續降低成本的途徑。台積公司與國際半導體組織（International SEMATECH, ISMI）及材料和設備供應商未來將持續合作，開發新的原物料，訂定微影策略方針，建立高效能的設備平台及環保製程，發展邁向十八吋晶圓的製程技術。

台積公司計劃在民國一百零二年到一百零三年間建立十八吋晶圓的試產線，並且在民國一百零四年到民國一百零五年間正式量產。

主要原物料暨供應鏈風險管理

民國九十九年，台積公司資材供應鏈管理處、各廠區、風險管理處及品質系統管理處，持續透過每月召開之供應鏈風險管理會議，進行供應鏈風險管理與改善計劃。台積公司也和供應商合作提升品質、交期、風險管理的成效，並支持綠色採購、環境保護和工業安全。

客戶夥伴關係

客戶

台積公司的客戶遍布全球，產品種類眾多，在半導體產業的各個領域中表現傑出，無晶圓廠設計公司的客戶包括Altera、AMD、Broadcom、Marvell、NVIDIA、Qualcomm、聯發科技等；整合元件製造商的客戶有Analog Devices、Freescale、NXP、Texas Instruments等。

客戶服務

為了促進與客戶的互動及資訊的即時交流，台積公司以網際網路為基礎，提供了更積極主動的設計、工程及後勤合作的「EFOUNDRY®」整合服務系統。設計合作可提供客戶在每一設計階段準確及最新的設計資訊；工程合作可提供客戶晶片良率測試及可靠度相關的工程資訊；後勤合作可每天提供三次客戶晶片在工廠封裝測試及運送的後勤資訊。

客戶滿意度

台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查，以確保客戶的需求得到了解與妥善照應，並達成高滿意度的服務。此滿意度調查係由中立第三者顧問公司透過網路或訪談來進行，台積公司針對客戶的意見提出改善計劃，並制訂有效的回報系統。台積公司視客戶滿意評估與調查的結果為企業績效指標，並堅信客戶滿意度的提升最終會促成客戶忠誠度及業務的成長。

【諾】

企業社會責任是我們對股東、員工及社會大眾的承諾。

5. 企業社會責任

台積公司實踐企業社會責任的十項原則，是我們持續為社會帶來正向發展的重要圭臬：

1. 堅持誠信正直，對股東、員工、及社會大眾皆同。
2. 遵守法律、依法行事、絕不違法。
3. 反對貪腐，拒絕裙帶關係；不賄賂、也不追求政商關係。
4. 重視公司治理，力求在股東、員工及所有利益關係人之間達到利益均衡。
5. 不參與政治。
6. 提供優質工作機會，包括良好的待遇、具有高度挑戰的工作內容，及舒適安全的工作環境，以照顧員工的身心需求。
7. 因應氣候變遷，重視並持續落實環境保護措施。
8. 強調並積極獎勵創新，並充分管控創新改革的可能風險。
9. 積極投資發光二極體照明以及太陽能等綠能產業，為環保節能盡一份心力。
10. 長期關懷社區，並持續贊助教育及文化活動。

環保、安全與衛生管理

台積公司於民國九十九年連續十年獲選列名道瓊永續指數之「世界指數」，同時成為該指數之半導體產業領導企業。其中環保面向評分獲得最高分，環境政策及環境管理的部分亦獲得滿分。

環境保護

溫室效應氣體排放減量

針對溫室效應氣體排放的環保議題，台積公司已積極進行相關排放減量措施。由於全氟化物是半導體廠主要的溫室效應氣體來源，台積公司與台灣半導體產業協會、行政院環境保護署與世界半導體協會已共同簽署備忘錄，主動制訂企業全氟化物排放減量政策及執行計劃，承諾於民國九十九年時，將全氟化物排放總量降至民國八十六年及八十八年平均值之90%以下。在公司不斷成長茁壯且持續擴建新廠之情形下，該減量目標仍是一總量之固定值。

台積公司不僅在新建廠房及辦公室採用節能設計，在營運階段亦持續提升能源效率。民國九十九年台積公司晶圓三廠第二次獲得經濟部之「節約能源績優獎」，此為超過十五年之舊廠仍可持續提升節約能源績效之良好範例。

空氣及水污染防治

台積公司各晶圓廠均設置空氣及水污染防治設備，並符合法規排放標準。此外，各種污染防治設備亦擁有緊急電源在內的備援設計，以確保萬一運轉中發生部分設備故障時，仍可由備援系統作為替代，降低污染物異常排放的風險。台積公司也將所有水污染防治、空氣污染防治設備的運轉狀況，納入中央監控系統，由每日二十四小時的輪值人員監控，並將系統效率檢知資訊列入重點追蹤項目，以確保空氣及廢水的排放品質。在新投入的LED廠與太陽能廠中，我們亦依據其環保、安全與衛生之特殊考量，進行如廢水、廢氣處理及製程設備危害防止等相關設計。

水資源節約

為有效利用台灣地區有限的水資源，台積公司各廠均透過調整設備製程用水量及改善廢水回收系統，致力提升製程用水回收率。其中新廠區的製程用水回收率皆達85%以上，符合或優於科學工業園區管理局所訂定的標準，亦優於國際間半導體廠製程用水回收率。此外，台積公司對於削減非製程用水也不遺餘力，例如減少空調用水、衛生設施使用回收水、管控外牆清洗與景觀澆灌用水與節約廚房用水等。我們亦使用公司內部網站系統，量測與收集全公司之水回收與重複使用量（如製程水回收）。

廢棄物管理與資源回收

台積公司成立專責單位統籌管理廢棄物。為了達到資源永續利用，台積公司對於廢棄物的管理，首重製程減廢，其次考量委外再利用或處理。為確實掌握廢棄物的流向，台積公司慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，並且訂有年度稽核計劃，確認其證照文件、現場操作情形與行車路徑動向，確保所有廢棄物均經合法妥善處理或再利用，避免造成二次環境污染。民國九十九年度，台積公司之廢棄物回收率為92%，已達成90%的目標，同時，衛生掩埋的比例亦降低至1%以下。

其他環保相關計劃

對於新建廠房及辦公室建築物設計，台積公司採用台灣「綠建築標準」及美國「節能環保設計標準」（LEED），較傳統之設計將更為節省能資源。同時，台積公司自民國九十七年開始逐年改善現有之辦公室建築物，以符合美國LEED標準。民國九十七年及民國九十八年，台積公司晶圓十四廠第三期廠房及晶圓十二廠第四期廠房分別獲得美國綠建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）綠建築評量系統「能源與環境先導設計—新建工程（Leadership in Energy and Environmental Design-New Construction, LEED-NC）」之黃金級標章以及台灣綠建築之鑽石級標章。這些計劃除特別聘請前美國綠建築協會副會長Dr. Kath Williams擔任專案顧問外，並且邀請我國學界專家指導。台積公司認為必須有更多企業興建綠色廠房，才能有效改善環境與平抑建材成本，因此不吝於將執行經驗推廣至產、官、學界。截至目前，已有來自產、官、學界與社區超過40個團體1,800位訪客，與台積公司就綠建築技術與實務經驗進行意見交流。台積公司相信將對的事做好以保護地球是值得做的事。

安全與衛生管理

台積公司的安全衛生管理架構在職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001）上，透過計劃、執行、檢查、行動循環管理（P-D-C-A）的管理精神，達成預防意外事故、促進員工安全衛生及保護公司資產的目標。台積公司所有位於台灣的廠區亦取得「台灣職業安全衛生管理系統」認證。

台積公司的安全管理除了致力於事故預防之外，亦擬定災害緊急應變程序，萬一災害發生時，可以保障公司員工與廠商人員的生命安全以及公司投資人的財產利益，並避免或降低事故災害發生時對社會與環境的衝擊。台積公司與設備供應商溝通以改善既有機台的潛在風險，並於機台安裝時依循裝機安全管制程序。此外，台積公司更嚴格要求落實高風險作業管制，進行廠務設施與設備耐震評估，以降低地震損失。

在衛生管理方面，台積公司除了推動一般健康衛生促進及特殊健康檢查之外，並積極進行職業衛生促進活動，如辦公室人因工程改善、建立餐廳衛生管理規則、重金屬物質衛生風險評估控制。針對傳染性疾病防治方面，亦成立公司級專責防疫委員會，針對如H1N1新型流感、SARS、禽流感等大型流行病，擬定相關防疫措施以降低營運風險。

民國九十九年環保、安全與衛生獲獎紀錄

- 連續十年獲選道瓊永續發展世界指數（Dow Jones Sustainability World Index）的組成企業，並為半導體業別的領導企業。
- 連續二年獲得台灣永續能源基金會「台灣企業永續報告金獎」。
- 原子能委員會「輻射防護作業評鑑優質獎」。
- 晶圓十二廠獲得行政院環保署「企業環保獎」。
- 晶圓十二廠第四期廠房獲得經濟部「節水績優獎」。
- 晶圓十二廠第四期廠房獲得新竹科學工業園區「低碳企業績優獎」。
- 晶圓十二廠第四期廠房獲得新竹科學工業園區「節水績優獎」。
- 晶圓十四廠獲得南部科學工業園區「節水績優獎」。
- 晶圓三廠獲得經濟部「節約能源獎」。
- 晶圓十二廠及晶圓三廠獲得新竹科學工業園區「勞工安全衛生優良單位」。

台積電文教基金會

台積公司於民國八十七年成立「台積電文教基金會」，透過「人才培育」、「社區營造」、「藝文推廣」及「企業志工」四大方向，善盡企業社會責任。

民國九十九年，台積電文教基金會持續投入資源，開啟「高中物理實驗學程」、更新國立自然科學博物館「半導體的世界」展館，及開創「台積科學之旅」等多項專案，以推動科普知識，鞏固科學教育基礎。除教育文化扎根的耕耘不輟，台積電文教基金會亦持續支持「台積志工社」，號召台積同仁以實際行動關懷社區弱勢，擴大企業對社會的關懷。

【信】

我們只說真話，絕不誇大事實，禁得起所有檢視。

戮力不懈，創造價值，

贏得客戶、供應商、股東、員工與社會大眾的信任，

更是客戶所信賴且賴以成功的重要夥伴。

6. 財務概況

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十五年至民國九十九年一月一日至十二月三十一日

(單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元)

	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度(註一)	九十五年度(註一)
銷貨收入總額	\$ 431,630,858	\$ 309,655,614	\$ 341,983,355	\$ 328,336,172	\$ 322,883,499
銷貨退回及折讓	12,092,947	13,913,375	8,825,695	5,705,576	5,476,328
銷貨收入淨額	419,537,911	295,742,239	333,157,660	322,630,596	317,407,171
銷貨成本	212,484,320	166,413,628	191,408,099	180,280,385	161,597,081
銷貨毛利	207,053,591	129,328,611	141,749,561	142,350,211	155,810,090
營業費用					
研究發展費用	29,706,662	21,593,398	21,480,937	17,946,322	16,076,432
管理費用	12,803,997	11,285,478	11,096,599	8,963,836	8,716,653
行銷費用	5,367,597	4,487,849	4,736,657	3,718,146	3,752,311
合計	47,878,256	37,366,725	37,314,193	30,628,304	28,545,396
營業利益	159,175,335	91,961,886	104,435,368	111,721,907	127,264,694
營業外收入及利益					
和解賠償收入	6,939,764	1,464,915	951,180	985,114	979,214
按權益法認列之投資淨益	2,298,159	45,994	701,533	2,507,869	2,347,153
利息收入	1,665,193	2,600,925	5,373,823	5,651,700	4,542,149
處分金融商品淨益	736,843	15,999	721,050	874,670	133,489
技術服務收入	450,503	367,013	1,181,966	590,391	571,500
金融商品評價淨益	320,730	594,660	-	63,017	-
處分固定資產及其他資產利益	216,199	113,963	100,874	91,210	421,051
租金收入	156,939	153,919	166,317	378,643	224,290
兌換淨益	-	-	1,227,653	80,922	-
補助款收入	-	-	8,029	364,321	334,478
其他收入	351,742	296,160	389,024	345,946	285,757
合計	13,136,072	5,653,548	10,821,449	11,933,803	9,839,081
營業外費用及損失					
處分固定資產損失	849,254	68,486	589	6,190	241,397
利息費用	425,356	391,479	614,988	842,242	890,602
災害損失	190,992	-	-	-	-
金融資產減損損失	159,798	913,230	1,560,055	54,208	279,690
兌換淨損	99,130	626,971	-	-	400,863
金融商品評價淨損	-	-	1,081,019	-	1,745,036
閒置資產損失	-	-	210,477	-	44,072
訴訟損失	-	-	99,126	1,008,635	-
其他損失	316,482	152,621	218,317	102,409	139,907
合計	2,041,012	2,152,787	3,784,571	2,013,684	3,741,567
稅前利益	170,270,395	95,462,647	111,472,246	121,642,026	133,362,208
所得稅費用	7,988,465	5,996,424	10,949,009	11,709,626	7,773,711
計列會計原則變動累積影響數前淨利	162,281,930	89,466,223	100,523,237	109,932,400	125,588,497
會計原則變動累積影響數(加計所得稅節省數82,062仟元後之淨額)	-	-	-	-	1,606,749
合併總淨利	\$ 162,281,930	\$ 89,466,223	\$ 100,523,237	\$ 109,932,400	\$ 127,195,246
歸屬于：					
母公司股東	\$ 161,605,009	\$ 89,217,836	\$ 99,933,168	\$ 109,177,093	\$ 127,009,731
少數股權	676,921	248,387	590,069	755,307	185,515
	\$ 162,281,930	\$ 89,466,223	\$ 100,523,237	\$ 109,932,400	\$ 127,195,246
每股盈餘(註二)					
基本每股盈餘	\$ 6.24	\$ 3.45	\$ 3.84	\$ 4.04	\$ 4.70
稀釋每股盈餘	\$ 6.23	\$ 3.44	\$ 3.81	\$ 4.04	\$ 4.69

註一：若干科目經重新分類，俾配合九十七年度財務報表之表達。

註二：按盈餘及資本公積轉增資比率(九十五年及九十七年盈餘年度)及員工紅利配股比率(九十五年及九十六年盈餘年度)追溯調整後之每股盈餘。

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十五年至民國九十九年十二月三十一日

(單位:新台幣仟元)

	九十九年 十二月三十一日	九十八年 十二月三十一日	九十七年 十二月三十一日	九十六年 十二月三十一日	九十五年 十二月三十一日
資產					
流動資產					
現金及約當現金	\$ 147,886,955	\$ 171,276,341	\$ 194,613,752	\$ 94,986,488	\$ 117,837,192
公平價值變動列入損益之金融資產	6,886	186,081	55,730	1,632,387	1,206,854
備供出售金融資產	28,883,728	14,389,946	10,898,715	66,688,368	67,523,858
持有至到期日金融資產	4,796,589	9,944,843	5,881,999	11,526,946	8,510,823
應收關係人款項	2,722	12,524	407	10,885	252,339
應收票據及帳款	51,029,885	44,637,642	25,023,321	47,204,126	34,957,650
備抵呆帳	(504,029)	(543,325)	(455,751)	(701,807)	(749,888)
備抵退貨及折讓	(7,546,264)	(8,724,481)	(6,071,026)	(4,089,035)	(2,870,802)
其他應收關係人款項	124,586	121,292	99,918	243,620	256,863
其他金融資產	1,021,552	1,849,987	1,911,699	1,515,527	2,356,542
存貨	28,405,984	20,913,751	14,876,645	23,862,260	21,430,728
遞延所得稅資產	5,373,076	4,370,309	3,969,330	5,572,334	8,013,992
預付費用及其他流動資產	2,037,647	1,368,838	1,813,692	1,370,230	1,591,017
流動資產合計	261,519,317	259,803,748	252,618,431	249,822,329	260,317,168
長期投資					
採權益法之長期股權投資	25,815,385	17,871,208	18,907,158	22,517,289	15,000,891
備供出售金融資產	1,033,049	1,358,049	2,032,658	1,400,691	6,648,485
持有至到期日金融資產	8,502,887	15,553,242	15,426,252	8,697,726	28,973,495
以成本衡量之金融資產	4,424,207	3,063,004	3,615,447	3,845,619	3,272,280
長期投資合計	39,775,528	37,845,503	39,981,515	36,461,325	53,895,151
固定資產					
成本					
土地及土地改良	891,197	934,090	953,857	942,197	844,644
建築物	145,966,024	142,294,558	132,249,996	118,640,027	112,595,124
機器設備	913,155,252	775,653,489	697,498,743	646,419,427	579,825,289
辦公設備	14,856,582	13,667,747	12,430,800	11,829,640	10,646,725
租賃資產	701,552	714,424	722,339	652,296	612,941
	1,075,570,607	933,264,308	843,855,735	778,483,587	704,524,723
累積折舊	(773,278,157)	(693,743,886)	(618,816,267)	(540,099,567)	(463,038,084)
預付款項及未完工程	86,151,573	34,154,365	18,605,882	21,868,167	12,607,551
固定資產淨額	388,444,023	273,674,787	243,645,350	260,252,187	254,094,190
無形資產					
商譽	5,704,897	5,931,318	6,044,392	5,987,582	5,984,993
遞延借項-淨額	6,027,085	6,458,554	7,125,828	7,923,601	5,936,915
無形資產合計	11,731,982	12,389,872	13,170,220	13,911,183	11,921,908
其他資產					
遞延所得稅資產	7,362,784	7,988,303	6,636,873	7,313,283	5,802,142
存出保證金	8,677,970	2,733,143	2,767,199	2,777,769	1,331,245
其他	1,417,300	260,864	97,001	327,150	123,355
其他資產合計	17,458,054	10,982,310	9,501,073	10,418,202	7,256,742
資產總計	\$ 718,928,904	\$ 594,696,220	\$ 558,916,589	\$ 570,865,226	\$ 587,485,159

	九十九年 十二月三十一日	九十八年 十二月三十一日	九十七年 十二月三十一日	九十六年 十二月三十一日	九十五年 十二月三十一日
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款	\$ 31,213,944	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
公平價值變動列入損益之金融負債	19,002	25	85,187	249,313	10,864
避險之衍生性金融負債	814	-	-	-	-
應付票據及帳款	12,104,173	10,905,884	5,553,151	11,574,882	7,934,388
應付關係人款項	867,085	783,007	489,857	1,503,376	1,867,728
應付所得稅	7,184,697	8,800,249	9,331,825	11,126,128	7,946,473
應付薪資及獎金	6,424,064	9,317,035	2,215,780	2,233,450	2,117,045
應付員工紅利及董監酬勞	11,096,147	6,818,343	15,369,730	-	-
應付工程及設備款	43,259,857	28,924,265	7,998,773	6,256,732	10,768,591
應付費用及其他流動負債	10,779,923	12,635,182	7,540,055	15,481,313	9,211,305
一年內到期之長期負債	241,407	949,298	8,222,398	280,813	7,004,137
流動負債合計	123,191,113	79,133,288	56,806,756	48,706,007	46,860,531
長期負債					
應付公司債	4,500,000	4,500,000	4,500,000	12,500,000	12,500,000
長期借款	301,561	578,560	1,420,476	1,722,196	653,959
其他長期應付款	6,554,208	5,602,420	9,548,226	9,409,978	8,703,267
其他應付關係人款項	-	-	-	-	403,375
應付租賃款	694,986	707,499	722,339	652,296	612,941
長期負債合計	12,050,755	11,388,479	16,191,041	24,284,470	22,873,542
其他負債					
應計退休金負債	3,812,351	3,797,032	3,701,584	3,665,522	3,540,060
存入保證金	789,098	1,006,023	1,484,495	2,243,009	3,817,132
遞延貸項	126,539	185,689	316,537	1,236,873	1,177,138
其他	254,643	137,161	43,709	43,774	78,640
其他負債合計	4,982,631	5,125,905	5,546,325	7,189,178	8,612,970
負債合計	140,224,499	95,647,672	78,544,122	80,179,655	78,347,043
母公司股東權益					
股本-每股面額10元					
普通股發行	259,100,787	259,027,066	256,254,373	264,271,037	258,296,879
資本公積	55,698,434	55,486,010	49,875,255	53,732,682	54,107,498
保留盈餘					
法定盈餘公積	86,239,494	77,317,710	67,324,393	56,406,684	43,705,711
特別盈餘公積	1,313,047	-	391,857	629,550	640,742
未分配盈餘	178,227,030	104,564,972	102,337,417	161,828,337	152,778,079
保留盈餘合計	265,779,571	181,882,682	170,053,667	218,864,571	197,124,532
股東權益其他項目					
累積換算調整數	(6,543,163)	(1,766,667)	481,158	(1,072,853)	(1,191,165)
金融商品未實現損益	109,289	453,621	(287,342)	680,997	561,615
庫藏股票	-	-	-	(49,385,032)	(918,075)
股東權益其他項目合計	(6,433,874)	(1,313,046)	193,816	(49,776,888)	(1,547,625)
母公司股東權益合計	574,144,918	495,082,712	476,377,111	487,091,402	507,981,284
少數股權	4,559,487	3,965,836	3,995,356	3,594,169	1,156,832
股東權益合計	578,704,405	499,048,548	480,372,467	490,685,571	509,138,116
負債及股東權益總計	\$ 718,928,904	\$ 594,696,220	\$ 558,916,589	\$ 570,865,226	\$ 587,485,159

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十五年至民國九十九年一月一日至十二月三十一日

(單位:新台幣仟元)

	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：					
歸屬於母公司股東之淨利	\$ 161,605,009	\$ 89,217,836	\$ 99,933,168	\$ 109,177,093	\$ 127,009,731
歸屬於少數股權之淨利	676,921	248,387	590,069	755,307	185,515
折舊及攤銷	87,810,103	80,814,748	81,512,191	80,005,395	73,715,242
金融資產折溢價攤銷數	34,142	21,483	(93,393)	(117,159)	2,399
金融資產減損損失	159,798	913,230	1,560,055	54,208	279,690
處分備供出售金融資產淨損(益)	(603,368)	20,337	(637,219)	(610,167)	(90,826)
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	(16,091)	-	-	-
處分以成本衡量之金融資產淨益	(133,475)	(20,245)	(83,831)	(264,503)	(16,210)
按權益法認列之投資淨益	(2,298,159)	(45,994)	(701,533)	(2,507,869)	(2,347,153)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	320,002	1,239,490	1,661,134	625,130	614,567
處分固定資產及其他資產淨損(益)	633,230	(45,475)	(100,285)	(85,020)	(179,654)
獲配股票作價賠償收入	(4,434,364)	-	-	-	-
提列閒置資產損失	319	-	210,477	-	44,072
遞延所得稅	(377,248)	(1,752,409)	2,279,414	943,797	121,590
營業資產及負債之淨變動：					
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	198,172	(215,513)	1,412,531	(187,084)	340,176
應收關係人款項	9,802	(12,117)	10,478	629,467	440,927
應收票據及帳款	(6,392,243)	(19,614,321)	22,180,805	(12,134,176)	8,124,625
備抵呆帳	(39,296)	87,574	(246,056)	(48,126)	(230,706)
備抵退貨及折讓	(1,178,217)	2,653,455	1,981,991	1,205,277	(1,446,611)
其他應收關係人款項	(3,294)	(21,374)	143,702	13,243	341,047
其他金融資產	740,959	7,834	(425,937)	842,136	(738,745)
存貨	(7,492,233)	(6,037,106)	8,985,615	(2,226,106)	(3,702,425)
預付費用及其他流動資產	(752,408)	585,430	(443,462)	290,434	(170,576)
應付票據及帳款	933,894	4,916,885	(6,021,731)	3,218,255	(1,487,646)
應付關係人款項	84,078	293,150	(1,013,519)	(375,731)	(572,441)
應付所得稅	(1,615,552)	(531,576)	(1,794,303)	3,179,655	3,931,022
應付薪資及獎金	(2,892,971)	7,101,255	(17,670)	116,405	665
應付員工紅利及董監酬勞	4,277,804	(1,056,399)	15,369,730	-	-
應付費用及其他流動負債	248,192	1,356,269	(3,936,757)	797,467	861,763
應計退休金負債	15,319	95,448	36,062	125,462	65,676
遞延貸項	(59,150)	(237,726)	(858,161)	343,878	(99,310)
營業活動之淨現金流入	229,475,766	159,966,465	221,493,565	183,766,668	204,996,986
投資活動之現金流量：					
購置固定資產	(186,944,203)	(87,784,906)	(59,222,654)	(84,000,985)	(78,737,265)
購置備供出售金融資產	(48,340,334)	(38,800,577)	(85,273,867)	(87,550,197)	(119,291,685)
購買持有至到期日金融資產	(4,101,501)	(12,224,353)	(16,523,275)	-	(18,554,027)
按權益法之長期股權投資增加	(6,242,350)	(42,947)	(55,871)	(5,803,826)	(2,613,009)
購買以成本衡量之金融資產	(1,812,928)	(321,195)	(463,211)	(911,323)	(511,632)
處分備供出售金融資產價款	37,816,288	36,039,978	138,515,023	94,908,666	91,620,367
持有至到期日金融資產領回	15,943,000	7,944,800	15,634,620	17,325,120	10,410,000
處分以成本衡量之金融資產價款	242,335	131,075	199,424	410,465	126,465
處分固定資產及其他資產價款	115,524	24,241	194,940	60,535	518,705
被投資公司減資退回股款	-	-	2,345,867	-	-
遞延借項增加	(1,801,728)	(1,469,831)	(3,395,287)	(3,059,155)	(1,414,742)
存出保證金減少(增加)	(5,944,827)	34,056	10,570	(1,434,895)	(1,224,443)
取得子公司淨支付現金數	-	-	-	(404,445)	-
其他資產減少(增加)	(1,015,458)	1,176	(8,163)	(228,747)	(52,086)
投資活動之淨現金流出	(202,086,182)	(96,468,483)	(8,041,884)	(70,688,787)	(119,723,352)

	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度	九十五年度
融資活動之現金流量：					
短期借款增加(減少)	\$ 31,213,944	\$ -	\$ -	\$ (89,720)	\$ (328,500)
舉借長期借款	-	286,574	98,400	653,000	-
償還公司債	-	(8,000,000)	-	(7,000,000)	-
償還長期借款	(967,034)	(378,673)	(468,313)	(196,173)	(5,489)
其他長期應付款減少	(1,107,333)	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	(232,925)	(478,472)	(758,514)	(1,574,131)	920,702
現金股利	(77,708,120)	(76,876,312)	(76,779,032)	(77,387,302)	(61,742,741)
員工現金紅利	-	-	(3,939,883)	(4,572,798)	(3,432,129)
董監事酬勞	-	-	(176,890)	(285,800)	(257,410)
受領贈與	49,021	-	-	-	-
員工行使認股權發行新股	244,824	260,533	227,150	436,827	575,197
買回庫藏股票	-	-	(33,480,997)	(45,413,373)	-
少數股權增加(減少)	(130,083)	(284,774)	(114,742)	19,004	487,017
融資活動之淨現金流出	(48,637,706)	(85,471,124)	(115,392,821)	(135,410,466)	(63,783,353)
現金及約當現金淨增加(減少)	(21,248,122)	(21,973,142)	98,058,860	(22,332,585)	21,490,281
匯率影響數	(2,141,264)	(1,364,269)	1,568,404	(518,119)	(136,796)
年初現金及約當現金餘額	171,276,341	194,613,752	94,986,488	117,837,192	96,483,707
年底現金及約當現金餘額	\$ 147,886,955	\$ 171,276,341	\$ 194,613,752	\$ 94,986,488	\$ 117,837,192
現金流量資訊之補充揭露					
支付利息	\$ 392,805	\$ 580,376	\$ 676,318	\$ 922,079	\$ 951,450
支付所得稅	\$ 9,818,418	\$ 8,088,124	\$ 10,477,018	\$ 7,585,727	\$ 3,630,029
同時影響現金及非現金項目之投資活動：					
購置固定資產價款	\$ 201,696,476	\$ 109,151,226	\$ 60,978,527	\$ 78,889,954	\$ 80,675,310
應付工程及設備款減少(增加)	(14,599,987)	(21,361,340)	(1,742,041)	5,111,031	(1,702,555)
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)	-	-	-
其他長期應付款增加	-	-	-	-	(235,490)
其他負債增加	(27,540)	-	-	-	-
應付租賃款增加	-	(4,171)	(13,832)	-	-
支付現金金額	\$ 186,944,203	\$ 87,784,906	\$ 59,222,654	\$ 84,000,985	\$ 78,737,265
購買備供出售金融資產價款	\$ 48,405,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
應付費用及其他流動負債增加	(65,541)	-	-	-	-
支付現金金額	\$ 48,340,334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
處分固定資產及其他資產價款	\$ 458,561	\$ 25,050	\$ 194,940	\$ -	\$ -
其他金融資產增加	(218,291)	-	-	-	-
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)	-	-	-
取得現金金額	\$ 115,524	\$ 24,241	\$ 194,940	\$ -	\$ -
買回庫藏股票	\$ -	\$ -	\$ 30,427,413	\$ 48,466,957	\$ -
應付費用及其他流動負債減少(增加)	-	-	3,053,584	(3,053,584)	-
支付現金金額	\$ -	\$ -	\$ 33,480,997	\$ 45,413,373	\$ -
不影響現金流量之融資活動：					
一年內到期之長期負債	\$ 241,407	\$ 949,298	\$ 8,222,398	\$ 280,813	\$ 7,004,137
一年內到期之其他應付關係人款項(帳列應付關係人款項)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 688,591
一年內到期之其他長期應付款及其他負債(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ 1,406,601	\$ 4,005,307	\$ 1,126,546	\$ 3,735,875	\$ 617,892

【承】

台積公司承諾以積極並具成本效益的方式，
整合並管理所有對營運及獲利
可能造成影響之風險。

聯絡資訊

公司總部及晶圓十二廠

300-78新竹科學工業園區力行六路8號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠

300-77新竹科學工業園區園區三路121號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781546

晶圓三廠

300-77新竹科學工業園區研新一路9號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781548

晶圓六廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號
電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5052057

晶圓八廠

300-78新竹科學工業園區力行路25號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號之1
電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5051262

北美子公司

2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：408-3828000 傳真：408-3828008

歐洲子公司

World Trade Center, Zuidplein 60,
1077 XV Amsterdam The Netherlands
電話：31-20-3059900 傳真：31-20-3059911

日本子公司

21F, Queen's Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku
Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan
電話：81-45-6820670 傳真：81-45-6820673

台積電(中國)有限公司

上海市松江區文翔路4000號
郵政編碼：201616
電話：86-21-57768000 傳真：86-21-57762525

台積電韓國有限會社

15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong
Gangnam-gu Seoul 135-080, Korea
電話：82-2-20511688 傳真：82-2-20511669

印度聯絡處

1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business
Park Bangalore-560071, India
電話：91-80-41768615 傳真：91-80-41764568

加拿大子公司

535 Legget Dr, Suite 600, Kanata, ON K2K 3B8
Canada
電話：1-613-576-1990 傳真：1-613-576-1999

公司發言人

姓名：何麗梅
職稱：資深副總經理暨財務長
電話：886-3-5054602 傳真：886-3-5670121
電子信箱：cyhsu@tsmc.com

代理發言人／法人關係

姓名：孫又文
職稱：企業訊息處處長
電話：886-3-5682080 傳真：886-3-5797337
電子信箱：elizabeth_sun@tsmc.com

簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：林鴻鵬、黃樹傑
105-96台北市民生東路三段156號12樓
電話：886-2-25459988 傳真：886-2-25459966
網址：<http://www.deloitte.com.tw>

辦理股票過戶機構

中國信託商業銀行股務代理部
100-08台北市重慶南路一段83號5樓
電話：886-2-21811911 傳真：886-2-23116723
網址：<http://www.chinatrust.com.tw>

ADR美國存託憑證存託銀行

Company: Citibank, N.A.
Depository Receipts Services
Address: 388 Greenwich Street, New York
NY 10013, U.S.A.
Website: <http://www.citigroup.com/adr>
Tel: 1-877-2484237 (toll free)
Tel: 1-781-5754555 (out of US)
Fax: 1-201-3243284
E-mail: citibank@shareholders-online.com
台積公司的美國存託憑證(ADR)在美國紐約證券交易所(NYSE)以TSM為代號掛牌交易。查詢海外有價證券資訊之方式：<http://www.nyse.com>以及<http://newmops.tse.com.tw>

Safe Harbor Notice:

The statements included in this business overview that are not historical in nature are “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. TSMC cautions readers that forward-looking statements are subject to significant risks and uncertainties and are based on TSMC’s current expectations. Actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including, among others, risks associated with cyclical and market conditions in the semiconductor industry; demand and supply for TSMC’s foundry manufacturing capacity in particular and for foundry manufacturing capacity in general; intense competition; the failure of one or more significant customers to continue to place the same level of orders with us; TSMC’s ability to remain a technological leader in the semiconductor industry; TSMC’s ability to manage its capacity; TSMC’s ability to obtain, preserve and defend its intellectual property rights; natural disasters and other unexpected events which may disrupt production; and exchange rate fluctuations. Additional information as to these and other risk factors that may cause TSMC’s actual results to differ materially from TSMC’s forward-looking statements may be found in TSMC’s Annual Report on Form 20-F, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on April 15, 2011, and such other documents as TSMC may file with, or submit to, the SEC from time to time. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.